

本資料由 (上市公司) 統懋 公司提供

序號	4	發言日期	103/06/26	發言時間	17:03:17
發言人	賴政麟	發言人職稱	海外事業部副總	發言人電話	06-5991621
主旨	公告本公司股東會決議辦理減資彌補虧損案				
符合條款	第 49 款	事實發生日	103/06/26		
說明	<p>1.事實發生日:103/06/26</p> <p>2.公司名稱:統懋半導體股份有限公司</p> <p>3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司</p> <p>4.相互持股比例:不適用</p> <p>5.傳播媒體名稱:不適用</p> <p>6.報導內容:不適用</p> <p>7.發生緣由:</p> <p>公告本公司股東會決議辦理減資彌補虧損案。</p> <p>8.因應措施:無。</p> <p>9.其他應敘明事項:</p> <p>(1)減資緣由:為改善財務結構,擬辦理減資以彌補累積虧損</p> <p>(2)減資金額:368,925,210元</p> <p>(3)消除股份:36,892,521股</p> <p>(4)減資比率:25%</p> <p>(5)減資後股本:1,106,775,640元</p> <p>(6)預定股東會日期:103/06/26</p> <p>(7)預計減資新股上市後之上市普通股股數及比率</p> <p>(減資後上市普通股數A、A/減資後已發行普通股):預計61,920,064股;55.95%</p> <p>(8)本公司非連續兩年度減資之公司,毋需編列健全營運計畫書及相關落實執行之控管措施,惟本公司將盡永續經營之企業責任,調整內部及市場策略,以減少公司虧損為目標。本公司未來將致力於提升新廠產能水準外,同時致力於降低公司成本,以提高產品之毛利率,在產品面亦培養重點客戶,調整公司產品的配比,以提升公司之獲利。在競爭力部分,公司新產品開發及良率之改善亦是努力之目標。</p> <p>(註1)本案視股東會通過,並呈送主管機關核准後,授權董事會訂定減資基準日及</p>				

辦理後續減資相關事宜。

(註2)本案如因主管機關核示或法令修訂時，擬授權董事會全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。